

SEDEX 2024

REVIEW

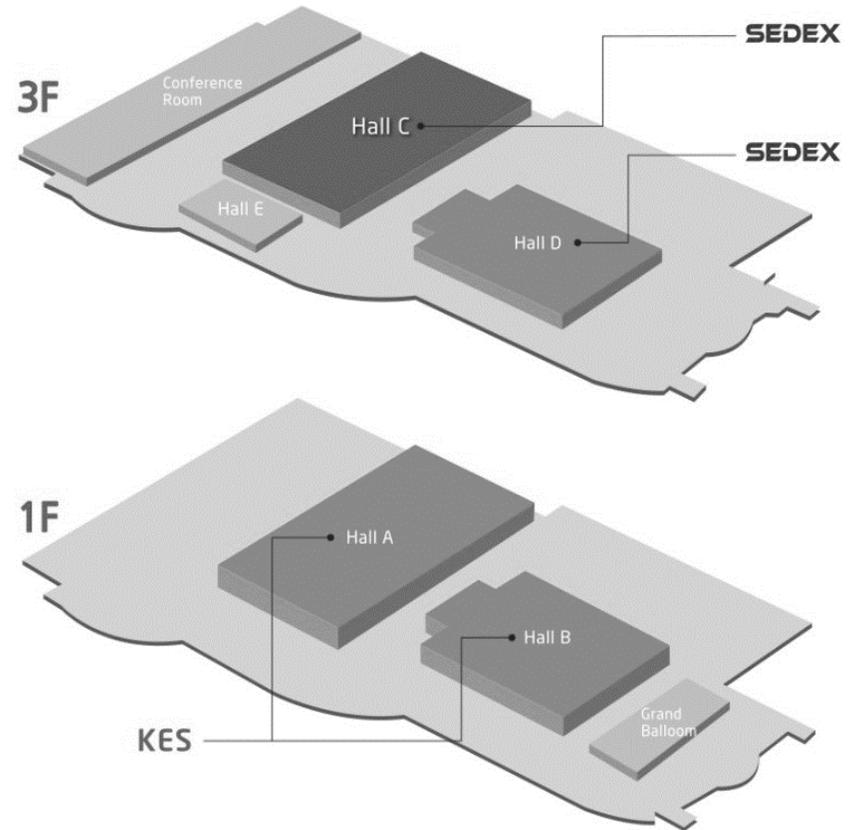
2024. 11.

[반도체 대표 전시회 SEDEX 2024 성공적으로 마무리]

- ✓ 국내 반도체 산업계 최대 행사인 반도체대전 'SEDEX 2024'가 사흘간의 일정을 마치고 폐막했다. 올해 반도체대전은 반도체 장비, 소재, 부품, 설계, 재료, 설비기업 등 **반도체 산업 생태계를 구성하는 쏠 분야 280개의 기업이 참여하여 700부스의 규모**로 치러졌다.
- ✓ 최근 AI 기술의 발전과 함께 주목받고 있는 패키징 기술과의 연계를 강조하여, 전시회 슬로건을 '**AI 반도체와 최첨단 패키지 기술의 융합**'으로 정하고 관련 분야에 심층적으로 접근할 수 있는 SEDEX Keynote 무대 또한 마련되었다.
- ✓ **삼성전자**는 'LPDDR5X', 'HBM3E', 'CMM-D' 등 고성능 차세대 메모리들을 선보였으며, AI시대에 걸맞는 첨단 패키지 솔루션인 'I-Cube', 'X-Cube'를 소개했다. 또한 이미지 센서 제품군의 'ISOCELL' 라인업과, 웨어러블용 애플리케이션프로세서(AP) '엑시노스W1000' 등 차세대 모바일 경험의 토대가 될 다양한 첨단 솔루션을 선보였다.
- ✓ **SK하이닉스**는 'HBM3E' 12단, 'CMM-DDR5', 'GDDR6-AiM' 등 차세대 AI 메모리를 비롯해 최신 규격의 서버용 'DDR5-RDIMM(1cm)', eSSD 라인을 전시했다. 또한 AI 비전을 실현시킬 용인 반도체 클러스터의 미래를 소개하는 별도 존을 마련하여 비전을 공유하였다.

1. SEDEX Overview

- ▶ 행사 : 2024 SEDEX (제26회 반도체대전)
- ▶ 장소 : COEX Hall C&D1 (3F)
 - * 한국전자展 : Hall A&B (1F)
- ▶ 기간 : 2024년 10월 23일(수)~25일(금)
- ▶ 규모 : 280개사 700부스
 - * 한국전자산업대전 800개사 2,000개부스 36,007㎡
- ▶ 관람 : 55,553명
 - * 한국전자산업대전(A~D홀) 64,341명 (6% 증가)
- ▶ 주관 : 한국반도체산업협회, 한국반도체연구조합
- ▶ 후원 : SK하이닉스, 삼성전자, 램리서치,
어플라이드머티리얼즈, 시놉시스



- 스마트폰, TV 등 반도체 수요제품부터 메모리반도체, 시스템반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서 등 반도체산업 **생태계 숲 분야가 참여**
- 전시회 참가기업 상호간 공급/수요기업이 되는 **산업 생태계형 전시회** 로 전시기간 동안 홍보·비즈니스의 장으로 활용 가능
- 캐나다, 영국, 인도, 미국, 일본 등 10개국 해외 기업의 참가로 글로벌 비즈니스 기회 제공
- **동일기간 같은 장소에서 한국전자展(KES)과 더불어 개최** 되는 ICT 전시회로 관련 다양한 기술정보 확보 및 홍보효과 기대

2. SEDEX Review

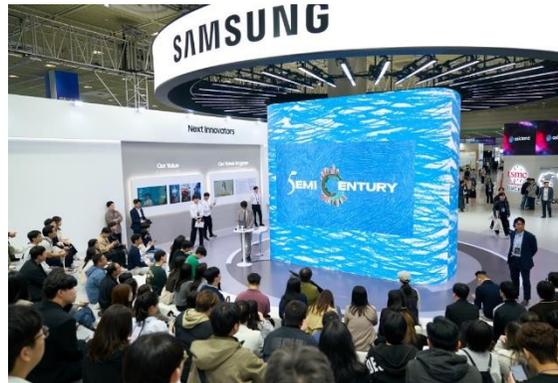


SEDEX Keynote

- ✓ 반도체대전 개막 이튿날인 10/24(목)에는 **SK하이닉스 이강욱 부사장**, **어플라이드 머티어리얼즈 코리아 박광선 대표**가 ‘AI 반도체와 최첨단 패키징 기술의 융합’, ‘Vision for the Future: Convergence of AI Chips and Advanced Packaging’을 주제로 키노트 스피치가 진행되었다.
- ✓ **SK하이닉스 이강욱 부사장**은 ‘AI 시대의 반도체 패키징의 역할’이라는 주제로 발표를 진행했다. SK하이닉스 이강욱 부사장은 “한국이 메모리, IDM 중심으로 성장하니 후공정 같은 연계 공정 경쟁력이 취약한 원인”, “단순히 반도체 트랜지스터 용량을 키우는 시대가 아닌, 패키징을 통해 SiP(System in Package)등의 형식으로 무어의 법칙을 넘어서는 시대가 도래했다”라며, “반도체 산업이 균형 있게 성장하기 위해서는 결국 첨단 패키징 기술이 있어야 한다”고 패키징의 중요성을 강조했다.
- ✓ **어플라이드 머티어리얼즈 코리아 박광선 대표**는 ‘반도체 산업의 미래: 에너지 효율적 컴퓨팅과 혁신의 가속화’ 주제로 기조연설을 진행했다. 박광선 대표는 “AI 기술의 발전으로 전력 효율의 우려가 커지고 있으며, 개선하는 것이 중요한 과제”라며, 어플라이드 머티어리얼즈의 다양한 반도체 장비 포트폴리오가 여러 공정을 통합하거나 최적화하는 솔루션을 제공할 수 있을 것이라고 밝혔다. 또한 “공정 효율뿐만 아니라 환경까지 고려하여 솔루션을 갖출 수 있도록 노력할 것”이라고 했다.



✓ 국내 반도체 기업과 소부장 기업들이 반도체대전에서 한층 높아진 기술력을 선보인다. ▲ **PSK**는 반도체 노광 공정 후 감광액을 제거하는 PR Dry Strip 장비를 소개했다. ▲ **엑시콘**은 AI 확산에 따라 차세대 메모리로 손꼽히는 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 칩셋의 검사 장비를 선보였다. ▲ 국내 대표적인 소재 기업인 **에프에스티**는 자체 설계 프레임을 구성으로 하는 고투과율의 EUV용 펠리클 기술을 공개했다. ▲ 국내 반도체 산업 클린룸 분야 국산화를 성공시켰던 **신성이엔지**는 클린룸 장비, 이차전지 드라이룸 등을 소개하였다. ▲ **주성엔지니어링**은 반도체 초미세화에 대응하는 원자층증착(ALD) 장비인 ‘가이던스 시리즈’를 선보였다. ▲ 국내 대표 장비 기업인 **원익PS**와 **케이씨텍**도 참가하여 자사 기술력을 선보였다.





✓ AI 반도체 및 시스템 반도체 분야에서도 많은 기업이 참여했다. ▲ **LX세미콘**은 고속 데이터 전송 솔루션, 터치 솔루션 등 핵심 기술과 디스플레이 프로세서 등 디스플레이 제품들을 선보였으며, 차량 모터 구동용 마이크로컨트롤러유닛(MCU) 등 차량용 반도체 또한 소개했다. ▲ 엠티용 AI 반도체기업 **딥엑스**는 자사개발 AI반도체인 'DX-M1'의 안정성과 효율성을 선보였고, 특히 저전력 발열 억제 특성을 강조하였다. ▲ **에이직랜드**는 SoC, 백엔드, 온디바이스AI 관련 자사의 반도체 설계 자동화 플랫폼인 'Aworld Magic', 'ALPS', 'TOAST' 를 소개하였다. ▲ **세미파이브**는 반도체의 수율, 연결, 성능을 극대화 시킬 수 있는 첨단 패키징 기술인 '칩렛 설계 솔루션'을 선보였다. ▲ 고효율 NPU 와 차세대 고성능 메모리 반도체용 IP를 개발하는 **오픈엠티테크놀로지** 또한 참여하였다.



- ✓ 이 외에도 최고의 반도체 기술력을 가지고 있는 기업들이 참여했다. ▲ **동진세미켐**은 하이브리드본딩(HCB)용 화학기계적연마(CMP) 슬러리(Slurry) 기술을 선보였다. ▲ **미코세라믹스**는 HBM 공정을 위한 TSV TC Bonder용 세라믹 ‘펄스 히터’를 소개했다. ▲ **인아그룹**은 계열사인 인아오리엔탈모터·인아텍앤코포·인아엠씨티·애니모션텍과 함께 반도체 업계의 니즈를 충족시키는 다양한 제품과 솔루션을 선보였다. ▲ **캠트로닉스**는 반도체 노광 공정에 쓰이는 포토레지스트(PR)의 주 원료인 고순도(5N) PGMEA 를 최초 공개했다. ▲ **큐알티**는 양성자 검사 방식의 우주·국방용 반도체 ‘신뢰성 평가 솔루션’을 공개했다.
- ✓ 이번 전시에서는 지난 전시보다 지방자치단체의 관심이 더 뜨거웠다. ▲ **충청북도, 전라남도, 용인특례시, 부천시, 강원특별자치도, 안성시, 이천시, 광주광역시, 구미시**에서 참여하였으며, 반도체 및 IT 산업 관련 정책과 투자 유치 활동을 적극적으로 펼쳤다. ▲ 주요 공통점으로는 관내 기업들과 공동관 운영, 투자 인프라와 세제 혜택 등 지원 정책 홍보, 특화 산업단지 및 클러스터 소개, 인재 양성 및 테스트베드 구축 전략 홍보 등이 있었다. ▲ 특히 각 지역의 강점을 부각하며 투자 매력을 알리고, 네트워크 형성과 판로 개척을 지원하고자 하는 의지를 강조하였다. 이를 통해 지역 산업 발전과 반도체 생태계 활성화를 도모했다.
- ✓ 국가관들의 관심도 여전했다. ▲ **캐나다**와 **영국**에서도 많은 반도체 기업들이 국가관으로 참여하였다. **캐나다**에서는 Blumind, CEMWorks, Daanaa Resolution Inc. 등 참여하였고, **영국**에서는 Edwards, Oxford Instruments, Paragraf 등이 참여하여 한국 기업과 더욱 활발한 교류를 기대하였다.



3. Floor Plan : 700부스

SEDEX 2024

Floor Plan

Hall C

C639 이동 전시	C640 포스트 전시	C641 연결 전시	C642 연결 전시	C643 연결 전시	C644 연결 전시	C645 연결 전시	C646 연결 전시	C701 무인물류	C703 인공물류	C705 제어물류	C707 제어물류	C709 제어물류	C711 제어물류	C713 제어물류	C716 제어물류	C719 제어물류	C721 제어물류		
C838 네온스타	C837 스타	C836 스타	C835 스타	C834 스타	C833 스타	C624 스타	C626 스타	C548 스타	C547 스타	C549 스타	C545 스타	C441 스타	C351 스타	C358 스타	C251 스타	C253 스타	C161 스타	C163 스타	C800 SAMSUNG
C624 스타	C626 스타	C548 스타	C547 스타	C549 스타	C545 스타	C621 스타	C622 스타	C541 스타	C542 스타	C544 스타	C433 스타	C435 스타	C341 스타	C343 스타	C345 스타	C241 스타	C243 스타	C149 스타	C151 스타
C811 스타	C536 스타	C537 스타	C534 스타	C425 스타	C331 스타	C333 스타	C335 스타	C236 스타	C238 스타	C234 스타	C137 스타	C138 스타	C042 스타	C049 스타	C045 스타	C051 스타	C032 스타	C030 스타	C026 스타
C601 스타	C526 스타	C523 스타	C421 스타	C423 스타	C321 스타	C328 스타	C329 스타	C226 스타	C227 스타	C228 스타	C229 스타	C125 스타	C128 스타	C032 스타	C030 스타	C026 스타	C025 스타	C021 스타	C022 스타
SEDEX INSIGHT ZONE	C516 스타	C517 스타	C514 스타	C413 스타	C415 스타	C316 스타	C317 스타	C211 스타	C218 스타	C119 스타	C121 스타	C122 스타	C117 스타	C017 스타	C025 스타	C020 스타	C021 스타	C026 스타	C011 스타
C506 스타	C507 스타	C508 스타	C509 스타	C405 스타	C407 스타	C306 스타	C307 스타	C201 스타	C203 스타	C107 스타	C101 스타	C103 스타	C006 스타	C007 스타	C004 스타	C011 스타	C001 스타	C002 스타	C004 스타

Hall D

SEDEX 이벤트존

입구

출구

4. Exhibitor List : 280개사

업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스						
하이델베르크 인스트루먼트 코리아	C001	씨오아이	C324	알티엠	C601	코미코	C103	국포대학교 화합물 반도체센터	C419	보부하이테크	C721	한국텍트로닉스	C229	NanoFocus AG	C517	케이씨텍	D211
나노엑스	C002	테스트메이션	C328	KSIA 반도체 인력양성 프로그램 특별관	C611	미코세라믹스	C103	마이다스시스템	C421	삼성전자	C800	에니모션텍	C231	트랜스온	C521	산성이엔지	D215
나노정밀코리아	C004	에이티메이션	C328	켄탑스	C621	쓰리에치코퍼레이션	C107	아드반테스트코리아	C423	통진씨메켄	D001	자비스테크	C233	모터온	C521	센서전력반도체공동관	D301
주원	C006	에스더물류베콤	C329	파스텍	C624	우양신소재	C113	인아오리엔탈모터	C425	주성엔지니어링	D009	나노종합기술원	C234	강원테크노파크	C523	이엘티센서	D301
THK PRECISION	C006	오디에이테크놀로지	C331	뷰트인더스트리코리아	C626	유에스티	C115	에스티아이	C433	캐나다대사관	D021	무역안보관리원	C236	서원오토메이션	C526	셀소허브	D301
토요타스코리아	C007	엘텍비전	C333	코어플로우코리아	C633	한국산업기술진흥원	C116	디엘티	C435	Blumind	D021	중국대학교 반도체인력양성 사업단	C238	옵니시스템스	C531	대구경북과학기술원	D301
성능평가 홍보관	C011	나노텍코리아	C334	인터엠 에이브이케이 코리아	C634	제덱스	C117	이라스	C439	CEMWorks	D021	NBK	C241	한국기초과학지원연구원	C532	제염체코	D301
안성시청	C017	팜테크	C338	프레스토솔루션	C635	렛유인에듀	C119	충북과학기술혁신원	C441	Daanaa Resolution	D021	에스피씨테크놀로지	C241	가나	C534	파워큐브세미	D301
창원기계공업고등학교	C020	원텍	C339	토마스케이블	C636	아진전자	C121	토마스엔지니어링	C441	icspi (eye-see-spy)	D021	씨케이디한국	C243	형원이엔지	C536	세닉	D301
충북반도체고등학교	C021	포항공과대학교 나노융합기술원	C341	템퍼스	C637	Sanyu Rec	C121	리드엔지니어링	C441	Procerto	D021	큐빅셀	C251	비전아이즈	C537	루미지엔테크	D301
한국나노마이스터고등학교	C025	마키노코리아	C343	넥슨전자	C638	넵스코리아	C122	에이엘티	C441	Stathera,	D021	모두솔루션	C253	코론	C541	약셀	D301
초격차기술개발사업 & 반도체 소부장 협력단	C026	뉴로클	C345	아큐레이저	C639	서울대학교 시스템반도체 산업진흥센터	C125	네펀스	C441	TransEON	D021	이즈소프트	C301	자비스	C542	퀀타머티리얼스	D301
K-CHIPS	C030	에스엠지	C348	에스디옵틱스	C640	차세대반도체 혁신융합대학	C128	어브브반도체	C441	Technum Québec	D021	스카이칩스	C302	나노코어	C544	시스템반도체기업 공동관	D317
부천산업진흥원	C032	휴엠	C350	엔젯	C641	해치텍	C137	심텍	C441	VentureLab	D021	델리다인 르크로이	C303	한양대학교 LINC3.0사업단	C545	켈리타스반도체	D317
에스피반도체통신	C032	충북도청/충북테크노파크	C351	한백정일	C642	세미파이버	C138	켄트로닉스	C501	리스광시스템	D025	두인에스제이테크	C304	그릿사이아씨	C545	칩스앤미디어	D317
삼일테크	C032	서울특별시교육청 취업지원센터	C353	위아코퍼레이션	C643	피에스케이	C149	이엘코퍼레이션	C503	엘엑스세미콘	D101	세라텍	C305	디알비헬스케어	C545	오픈엠티테크놀로지	D317
피에스엠피	C032	레이피아	C355	메타솔	C644	에이디테크놀로지	C151	티옵틱스	C504	에프에스티	D111	위드시스템	C306	액트로	C545	바움디자인시스템즈	D317
큐인테크	C032	크린컨테크	C358	에이치엘옵틱스	C645	에이엔아이	C161	용비이엔지	C506	큐알티	D115	한국지노	C307	미르기술	C546	하이퍼액셀	D317
인우하이텍	C032	키엔스코리아	C401	유나젯	C646	에이직랜드	C163	서울테크놀로지	C507	엑시콘	D117	신코테크	C308	두루무역	C547	뉴링크테크놀로지	D317
광주광역시청	C042	성엔지니어링	C403	우일플루곤	C701	제4기한국	C201	아이엔씨테크놀로지	C508	와이씨	D117	잇다반도체	C309	진성나노텍	C549	아크칩스	D317
와이텍	C045	에버던트코리아	C405	심플플롬	C703	한국알박	C203	한국알타어	C509	샘씨엔에스	D117	에스씨에스	C310	대상엔지니어링	C553	수퍼게이트	D317
Carlo Gavazzi	C045	디피아이엔	C407	제이씨솔루션	C705	케이에스엠펜포넌트	C211	후지이미지테크	C511	답엑스	D127	나노시스템	C311	모벤시스	C555	쇼어솔루션	D317
록스텍코리아	C049	삼우이머션	C409	제이오텍	C707	베스텍	C218	경기테크노파크	C512	용인특레시	D133	오토센서코리아	C312	원에스티	C559	블루닷	D317
차세대지능형반도체 기술개발사업	C051	한국지식재산보호원	C411	구미시	C709	인포비온	C221	주한영국대사관	C514	애플티	D133	피엔티	C313	이엘엠	C561	솔리드뷰	D317
사피엔반도체	C051	메를러 토레도 코리아	C413	다우셀브	C711	어블리드	C223	Edwards Vacuum	C514	서플러스글로벌	D133	에스에스 오토론	C314	반도체월드 Showcase 2024	C601	레오에스엔에스	D317
에어포인트	C051	성균관대 융복합 센서 소재공정 플랫폼	C415	한국기계전자시험연구원	C713	피에스텍	C224	Oxford Instruments	C514	이규글로벌	D133	밀레니엄옵틱칼시스템	C316	넥서스비	C601	비트리	D317
큐알티	C051	엠케이피	C417	동일브레이크	C716	버브세미 마이크로 일렉트로닉스	C225	QuiNas	C514	위크론	D133	엠씨파타스	C317	아이에스피	C601	이디엔씨	D317
엔플렉스	C101	전라남도 반도체 공동관	C419	플루토솔루션	C719	S&P Tech	C225	Paragraf	C514	에스티코퍼레이션	D133	필타이아스	C318	에임류처	C601	램셀	D317
						아이플렉스	C226	Intralink Korea	C514	이천시청	D201	퍼닉스	C319	퓨리언스	C601	알파솔루션즈	D317
						XP POWER	C227	브로드텍 인터내셔널	C516	한국세라믹기술원 이천분원	D201	한국전자기술연구원	C321	마인즈아이	C601	유니컨	D317
						주은에스에스	C228	아이엘티	C517	원익아이피에스	D207	라드피온	C323	킴스래퍼런스	C601	SK하이닉스	D400

※ 반도체대전 참가사의 제품품목, 회사소개 등 기타 자세한 사항은 [SEDEX 홈페이지](#) - <참가업체 디렉토리>에서 확인 가능합니다.

5. SEDEX Program

Seminar Program

프로그램 총괄

10월 23일(수)

장소	시간	프로그램	주최
307호	09:00~17:10	제7회 반도체 산학연 교류 워크샵	반도체소사이어티 산하 전문연구회
301호	09:30~16:00	2024년 반도체·디스플레이 환경·안전 정책 세미나	한국반도체산업협회
328호	13:00~15:00	2024 반도체 공정·장비 지능화 세미나	한국반도체연구조합, 한국전자기술연구원, 한국산업지능화협회
402호	14:00~17:00	반도체시장 시장/정책 동향 세미나	한국반도체산업협회

10월 24일(목)

장소	시간	프로그램	주최
401호	14:00~15:20	SEDEX 2024 Keynote	한국반도체산업협회
301호	09:00~17:00	2024 캐나다-한국 반도체 이노베이션 포럼	주한캐나다대사관
307호, 308호	10:00~17:00	제7회 반도체 산학연 교류 워크샵	반도체소사이어티 산하 전문연구회, 한국반도체산업협회
317호	11:30~13:00	구미시 투자유치 설명회	구미시청, 구미전자정보기술원
403호	10:30~14:00	반도체 첨단패키징 R&D 국제 컨퍼런스	한국산업기술기획평가원, 한국반도체연구조합

SEDEX Insight Zone

반도체 양산성능평가 TECH-DAY

10.23(수)

- ✓ 반도체 양산성능평가사업 우수사례 발표
- ✓ 반도체 양산성능평가 신규 공급기업 유치 및 품목발굴 교류

기업투자유치 설명회

10.24(목)

- ✓ 네덜란드 투자진흥청 / 네덜란드 대사관, 충북도청, 광주광역시, 부천시, 이천시, 안성시 참여

반도체 IR Conference 2024

10.25(금)

- ✓ 피엔피네트워크, 알티엠, 세닉, 퓨리언스, 알앤에스랩 등 IR기업 - 투자자 교류 및 상담

6. SEDEX Event

온/오프라인 이벤트 개최

유튜브 이벤트

SEDEX와의 추억을 소환해주세요!

응답하라 SEDEX

참여 방법  YouTube SEDEX Semiconductor Exhibition

- STEP 1 유튜브 채널 알림, 구독
- STEP 2 게시물을 좋아요! 
- STEP 3 응답 댓글 참여
- STEP 4 설문양식 작성

우수응답상
에어팟 6명

감사응답상
커피쿠폰 20명

카드뒤집기 이벤트

SEDEX 2024 현장이벤트
두근두근
카드뒤집기

2024 SEDEX

단 3일간, SEDEX 전시장 이벤트존

참관객 출입증 바코드를 소지하신 분만 참여 가능, 1일 1회 참여 가능

8. SEDEX 2025 준비



개최 개요

- 명 칭 : 제27회 반도체대전 (SEDEX 2025)
- 기 간 : 2025년 10월 22일(수) ~ 24일(금), 3일간
- 장 소 : 서울 삼성동 COEX Hall C & D1
- 주 최 : 산업통상자원부
- 주 관 : 한국반도체산업협회, 한국반도체연구조합
- 참가사 : 메모리 반도체, 시스템 반도체, 장비·부분품, 재료, 설비, 센서 등 반도체관련 기업

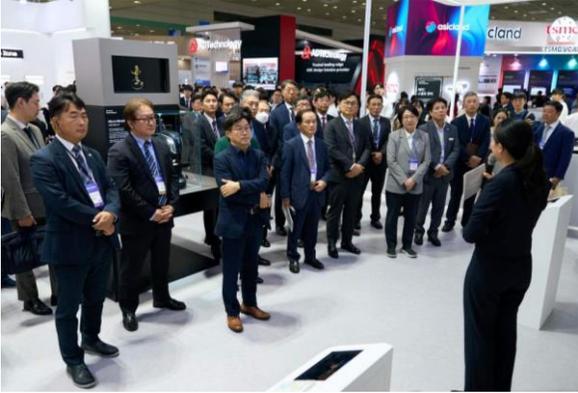
참가 신청



- 1차 : ~2024.12.31(화) ⇨ 참가비 15% 할인
- 2차 : ~2025.04.30(수) ⇨ 참가비 10% 할인
- 3차 : ~2025.06.30(월) ⇨ 참가비 5% 할인
- * 3년(2023~2025년) 연속 참가기업 추가할인 5%

* 부스 소진 시 조기 마감

9. SEDEX Photo Gallery



감사합니다